

## 光芯片厂商的调研

1.2027 年 CW 供需仍偏紧，涨价客户可接受 2028 年平衡。谷歌光芯片需求 2026 年约 2 亿颗、2027 年 4 亿颗、2028 年 8 亿颗。国内 CW 扩产更快，2028 年行业瓶颈或转向 DSP、隔离器等器件。

2.OCS2026 年可供 4000 至 4500 台，2027 年产量超 1 万台，后续计划交由 Fabrinet、Celestica 等代工。DCI 需求强劲，Pump Laser 和 ITLA 年化增长约 50%。2027 年 1.6T 光模块预计 100 万至 150 万只，泰国工厂产能优先分配给 OCS。

3.2027 年芯片板块营收预计增长 60%，产品整体涨价 10%-15%、产能增加 50%，共同支撑业绩增长。

4. 各类芯片价格均会上调，单颗涨价约 1 美元，低功率 CW 单价 4 美元，涨幅约 25%，但低功率 CW 整体占比不高。

5.2027 年高功率芯增量较大，明年下半年半数裸芯片或按 ELSFP 形式供货英伟达，单颗芯片 35 美元、模组单价 550 美元，ELS 模组部分收入归入 components 板块。

6.大陆厂商扩产背景下,2027年CW供需仍失衡、价格可落地上涨;到2028年行业扩产充分。

7.国内CW厂商产能快速爬坡,yj等厂商2028年产量接近2亿颗,本公司2028年芯片产出预计至少4亿颗,2028年CW供需明显缓解。

8.MOCVD外延、磷化钢衬底存在扩产卡点,但2028年CW供应仍会大幅缓解,产品议价权下降,当前5美元单价2028年无法维持。

9.谷歌光芯片需求逐年翻倍、整体需求旺盛但行业多环节存在供给卡点。2028年CW不再是行业瓶颈,瓶颈转移至DSP、隔离器等器件。

10.公司2028年芯片产能规划预计扩至4亿颗。

11.OCS扩产进展顺利,原有工厂同步生产DCI、OCS、WSS等产品。后续将泰国工厂非光模块、非OCS产线转交代工厂,空余产能供给OCS,2027年OCS产能基本触顶,2028年或新增代工产能。

12.公司目前对接Fabrinet、Celestica等多家代工厂筛选合作方,Celestica具备谷歌OCS代工经验、合作概率更高,代工名单最快今年七八月份确定,现阶段优先扩产自有产能。

13. DCI 需求持续强劲, PumpLaser 可维持两至三年高增, ITLA 今明两年增速约 50%。PumpLaser 由本公司与 Coherent 垄断、议价权高, ITLA2028 年下半年份额或被竞品分流。

14. DCI 业务整体年化增速 20%-30%, 板块毛利率持续提升。

15. Pump Laser 主要对手为 Coherent;ITLA 竞争格局更广, 包含 Ciena、诺基亚、Coherent、昂纳、古河等;光模块领域有诺基亚、思科、德科立、光迅等玩家。

16. 工业激光系统与 VCSEL 业务整体保持稳定。

17. 云晖光模块出货数量维持不变, 营收依靠产品结构升级提升。泰国工厂优先保障 OCS 产能, OCS 毛利率高于 1.6T 光模块。

18. 行业多数产能锁定至 2027 年年终, 2027 下半年及 2028 年订单目前处于洽谈阶段、尚未落地。DCI 短期将锁定 2027 下半年及 2028 年订单。

19. OCS2027 年订单已排满, 2028 年订单预计今年七八月份集中锁定, 行业多数产能将在短期完成预定。

20.100GEML 需求 2027 年达巅峰后快速下滑, 200GEML 持续增长, 未来两三年 EML 产品不会消失。

21.CW 产品占比持续快速提升, 2028 年公司至少一半芯片产能将用于 CW 生产。